PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05170875 A

(43) Date of publication of application: 09 . 07 . 93

(51) Int. CI

C08G 59/24

C08G 59/62

C08K 3/00

C08L 63/00

(21) Application number: 03340985

(22) Date of filing: 24 . 12 . 91

(71) Applicant:

MITSUI TOATSU CHEM INC

(72) Inventor:

URAGAMI TATSUNOBU YAMAGUCHI KEISABURO YAMAGUCHI TERUHIRO

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION

(57) Abstract:

€2,

PURPOSE: To obtain a composition excellent in heat resistance, moisture resistance, adhesiveness, mechanical properties and workability by incorporating specified curing agents into an epoxy resin made by reacting a naphtholaralkyl resin with epichlorohydrin.

CONSTITUTION: An epoxy resin composition containing an epoxy resin and curing agents, wherein the epoxy resin is one obtained by reacting a naphtholaralkyl resin of formula I with epichlorohydrin of formula II and the curing agents are a naphtholaralkyl resin of formula I and a phenol- dichloropentadiene resin of formula III or a phenolaralkyl resin of formula IV. In the formulas, n is 0 to 100; r is 0 to 10; and R_1 is H, 1-9C alkyl or phenyl.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

Π

(11)特許出願公開番号

特開平5-170875

(43)公開日 平成5年(1993)7月9日

(51) Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	FI .		技術表示箇所
CO8G 59/24	NHQ	8416-4J			
59/62	NJR	8 4 1 6 - 4 J			
C08K 3/00	NKT	7167-4J			
C08L 63/00	NJR	8830-4J			
			審査	請求 未請求 請求項6	D数2 (全11頁)
(21)出願番号	特願平3-340	9 8 5	(71)出願人	· · · · · · · · · · · · · · ·	
/00\ III	W-20-7-1100	1) 105045		三井東圧化学株式会社	
(22)出願日	平成3年(199	1) 12月24日	(70) St ED 45	東京都千代田区霞が関	二」目2番5号
			(72)発明者	浦上 達宣	
			·	神奈川県横浜市栄区笠	
			(72)発明者	三井東圧化学株式会社 山口 桂三郎	M
			((2)光明省	四口	
				三井東圧化学株式会社	
·		4	(72)発明者	山口 彰宏	r)
	363		(12/元-914	神奈川県横浜市栄区笠	四町1100平44
				三井東圧化学株式会社	
		·	(74)代理人		• •
			1 (四)代程人	开牲工 取工 止入即	
			1		

(54)【発明の名称】エポキシ樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】 耐熱性及び耐湿性を同時に満足し、機械的物性が良好で、封止剤に使用した場合に、耐クラック性に優れたエポキシ樹脂を提供する。

【構成】ナフトールアラルキル樹脂に、エピクロルヒドリンを反応させて得られるエポキシ樹脂及び硬化剤ナフトールアラルキル樹脂並びに他の硬化剤フェノールージシクロペンタジエン樹脂又はフェノールアラルキル樹脂からなるエポキシ樹脂組成物。又は、これらエポキシ樹脂、併用する硬化剤及び無機充填剤からなるエポキシ樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】エポキシ樹脂および硬化剤を含有してなる エポキシ樹脂組成物において、 (A) エポキシ樹脂成分として、一般式 (I) (化1) 【化1】

(但し、式中nは0~100までの整数を示す。)で表されるナフトールアラルキル樹脂に、式(II) (化

2) 【化2】

(II)

で表されるエピクロルヒドリンを反応させて得られるエ ポキシ樹脂、 (B) 硬化剤として、(a) 一般式(I) (化3) 【化3】

(但し、式中nは $0\sim100$ までの整数を示す。) で表されるナフトールアラルキル樹脂および、(b) 一般式

(III) (化4) 【化4】

(但し、式中rは0~10の整数を示し、R、は水素原子、炭素数1~9のアルキル基、またはフェニル基を示す。) で表されるフェノールージシクロペンタジエン樹

脂、あるいは一般式 (IV) (化5) 【化5】

(但し、式中mは $0 \sim 100$ の整数を示す。) で表されるフェノールアラルキル樹脂、

より得られるエポキシ樹脂組成物。

【請求項2】エポキシ樹脂、硬化剤および無機充填剤を

含有してなるエポキシ樹脂組成物において、 (A) エポキシ樹脂成分として、一般式(I)(化6) 【化6】

(但し、式中nは0~100までの整数を示す。) で表 10 7) されるナフトールアラルキル樹脂に、式(II)(化 【化7】

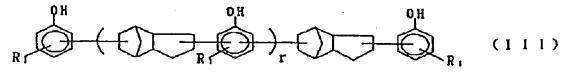
(II)

で表されるエピクロルヒドリンを反応させて得られるエ ポキシ樹脂、

(B) 硬化剤として、(a) 一般式(I) (化8) 【化8】

(但し、式中nは0~100までの整数を示す。) で表 されるナフトールアラルキル樹脂および、(b)一般式

(111) (化9) [化9]



(但し、式中rは0~10の整数を示し、R, は水素原 子、炭素数1~9のアルキル基、またはフェニル基を示 す。) で表されるフェノールージシクロペンタジエン樹

脂、あるいは一般式(IV)(化10) 【化10】

(但し、式中mは0~100の整数を示す。) で表され るフェノールアラルキル樹脂、

(C) 無機充填剤、

を用いて得られるエポキシ樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規にして有用なエポ

性、接着性、機械的性質および作業性に優れる注型、積 層、接着、成形、封止、複合材等の用途に適したエポキ シ樹脂組成物に関するものであり、実際に利用され得る ものとして具体的に例示すれば、半導体集積回路(I C) の封止用成形材料等に関するものである。

[0002]

【従来の技術および問題点】かかる用途におけるエポキ キシ樹脂組成物に関する。更に詳細には、耐熱性、耐湿 50 シ樹脂組成物において、従来用いられてきたエポキシ樹

6 .--

脂、あるいは硬化剤は数多くある。例えば、エポキシ樹脂の典型としては、2,2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロバン(ピスフェノールA)から得られる液状~固形の各種エポキシ樹脂、ノボラック樹脂から得られるエポキシ樹脂等があり、また高耐熱性エポキシ樹脂としては4,4 ージアミノジフェニルメタン(MDA)から得られるエポキシ樹脂等がある。

【0003】また、硬化剤の典型としてはジエチレントリアミン、イソホロンジアミン、m-キシリレンジアミン、m-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフ 10 エニルスルホン等の脂肪族または芳香族アミン化合物、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、無水マレイン酸等の酸無水物、フェノールノボラック等のフェノール樹脂、その他ポリアミド、変成ポリアミン類、イミダゾール類等である。これらのエポキシ樹脂および硬化剤を、各用途により様々な組合せで硬化させ、さらには無機充填剤を用いて樹脂組成物として利用してきた。

【0004】しかしながら、これら従来用いられてきた エポキシ樹脂や硬化剤を用いて得られるエポキシ樹脂組 20 が 成物は性能的に一長一短があり、各利用分野における技 、 術の向上に伴って必然的に要求される高い水準の性能を 満足し得るものとは言い難い。

【0005】すなわち、耐熱性、耐湿性、機械的強度等、各性能がパランス良く高い水準にあり、さらには作業性においても優れるエポキシ樹脂が求められる様になってきており、例えば従来oークレゾールノボラックの組合せが多く用いられてきたが、この組合せから得られるエポキシ樹脂とフェノールノボラックの組合せが多く用いられてきたが、この組合せから得られるエポキシ樹脂組成物は、機械的強度は比較的高い水準にあるが、耐湿性に問題があるため、近年の各産業の発生、発生熱量の増大による耐熱性の不足等、最終的な製品の信頼性に関わる問題が指摘されている。

【0006】この様な問題に対して、近年、エポキシ樹脂組成物の耐熱性の向上や耐湿性を向上させる目的で幾つかのエポキシ樹脂、硬化剤が提案されている。例えば、硬化剤として4、4'ージアミノジフェニルメタンや4、4'ージヒドロキシジフェニルスルホンを用いたり、あるいはエポキシ主剤としてそれらのエポキシ化物を用いることにより、高耐熱性のエポキシ樹脂組成物を得ることができることは既に公知である。しかしながら、これらは構造的に耐湿性に劣るものとなり、問題の解決にはなっていない。

【0007】また、本発明に用いられる(a)一般式(I)で表されるナフトールアラルキル樹脂を硬化剤に

用いるエポキシ樹脂組成物(特公昭48-10960)、(b)一般式(III)で表されるフェノールージシクロペンタジエン樹脂を硬化剤に用いるエポキシ樹脂組成物(特開昭61-250300、61-250301)、(c)一般式(IV)で表されてるフェノールアラルキル樹脂を硬化剤に用いるエポキシ樹脂組成物(三井東圧化学製:商品名 ミレックス X L 2 2 5)等が耐湿性に優れるものとして見出されており、特に

(a)の一般式(I)で表されるナフトールアラルキル樹脂、(b)の一般式(III)で表されるフェノールージシクロペンタジエン樹脂を用いて得られるエポキシ樹脂組成物は、耐熱性においても非常に優れた性能を示すものであるが、(a)の一般式(I)で表されるものの、樹脂の溶融粘度が高いため、使用時には過剰な加熱、あるいは本来不要な溶剤を使用しなければ配合、混練等の作業が困難であり、(b)の一般式(III)で表されるフェノールージシクロペンタジエン樹脂は、耐熱性、耐湿性は優れるが、若干機械的な物性に劣り、(c)の一般式(IV)で表されてるフェノールアラルキル樹脂は耐湿性、機械的物性は優れるが耐熱性に劣るという、それぞれの欠点がある。

【0008】また、主剤となるエポキシ樹脂の持つ特性により、最終的に得られる樹脂組成物の性能も左右されてしまうものである。このため、これらの硬化剤を用いることによる耐湿性や耐熱性の向上は、各産業分野の技術の発達、それに伴う要求性能に必ずしも充分に応え得るものであるとは言えない。また、製品の小型化、高集積化により必然的に薄層化が求められる樹脂部は、より一層の冷熱変化に対する強さが求められ、熱膨張係数の低下、冷熱変化における低歪化等も要求されており、エポキシ主剤および硬化剤の改良が強く求められている。【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、耐湿性、耐熱性、接着性、機械的強度および作業性等の性能のパランスの優れたエポキシ樹脂組成物を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明を完成するに至ったものである。すなわち、本発明は、エポキシ樹脂および硬化剤を含有してなるエポキシ樹脂組成物において、

(A) エポキシ樹脂成分として、一般式 (I) (化1)

【化11】

(但し、式中nは0~100までの整数を示す。) で表 2) されるナフトールアラルキル樹脂に、式(II) (化1 10 【化12】

CH: -CH-CH: C1

(II)

で表されるエピクロルヒドリンを反応させて得られるエ ポキシ樹脂、 (B) 硬化剤として、(a) 一般式(I) (化13) 【化13】

(但し、式中nは0~100までの整数を示す。) で表 されるナフトールアラルキル樹脂および、(b) 一般式 (III) (化14) 【化14】

(但し、式中rは0~10の整数を示し、 R_1 は水素原子、炭素数1~9のアルキル基、またはフェニル基を示す。) で表されるフェノールージシクロペンタジエン樹

脂、あるいは一般式 (IV) (化15) 【化15】

(但し、式中mは0~10·0の整数を示す。) で表されるフェノールアラルキル樹脂、

を併用して用いることにより得られる耐熱性、耐湿性、接着性、機械的性質および作業性に優れたエポキシ樹脂組成物であり、さらに無機充填剤をも含有してなるエポキシ樹脂組成物である。

【0011】本発明においてエポキシ樹脂原料あるいは硬化剤として用いられるナフトールアラルキル樹脂は、特公昭47-15111、特願平3-165923により製造される。このナフトールアラルキル樹脂は、一般式 (V) (化16)

[化16]

$$R_{2}CH_{2} \longrightarrow CH_{2}R_{2} \qquad (V)$$

10

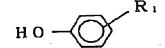
20

30

10

(式中、R、はハロゲン原子、水酸基、または炭素数 1 ~ 4 の低級アルコキシ基を示す。) で表されるアラルキルハライド、またはアラルキルアルコール誘導体に、酸触媒の存在下において、1 、 1 倍モル以上の α - ナフトール、または β - ナフトールを反応させ、必要により未反応ナフトールを留去することにより得ることができる。

【0012】本発明において、一般式(I)のナフトールアラルキル樹脂をエポキシ化する方法は、特開平3-90075によって示されているように公知慣用の方法が用いられる。すなわち、ナフトールアラルキル樹脂と、そのヒドロキシル基に対して1~20倍モル、好にないであり、反応形態としては別えば100~115℃に加熱されたナフトールアラルキル樹脂とエピハロヒドリンを塩基の存在下において反応でものであり、反応形態としては例えば100~115℃に加熱されたナフトールアラルキル樹脂とエピハロヒドリンとの混合物に水酸化ナトリウム水溶液を滴下していく方法が挙げられるが、その他の方法を用いることもできる。また、反応の際4級アンモニウム塩等の相関移動触媒を用いることも制限されることはない。



(但し、式中R、は水素原子または炭素数1~9のアルキル基を示す。)で表されるフェノールまたは、りアルキルフェノールを1~20モル反応させることにより得ることができる。この時、無触媒で高温、高圧下に共なて反応を行う方法では、得られる樹脂は完全な酸触媒であること、またルイス酸触媒があることができる。ない可能性があること、またルイス酸触球は、で三ふっ化ほう素およびその錯体を用いる方法では、「校容器の材質、樹脂中への触媒の混入、樹脂の水ででは、「なっないちの問題を解決した技術、特願平2-291872、2-291873、2-295489、2-295490によりアルカンスルホン酸、パーフルオン酸、パーフルオン酸、パーフルオン酸、パーフルオン酸、パーフルオン酸、パーフルオン酸、パーフルオン酸型強酸性イオン交換樹脂、スルホン酸型強酸性イオン交換樹脂、スルホン酸型強酸性イオン交換樹脂を触媒として製造されることが望ましい。

【0015】同様に本発明において用いられるフェノールアラルキル樹脂は、特公昭47-15111、特願昭62-70282等により製造される。すなわち前述のナフトールアラルキル樹脂と同様に、一般式(III)で表されるアラルキルハライド、またはアラルキルアルコール誘導体に、酸触媒の存在下において、1.1倍モル以上のフェノール類を反応させ、必要により未反応フェノール類を留去することにより得ることができる。

【0016】本発明において用いられるエポキシ樹脂と 脂および硬化硬化剤の使用量は、エポキシ樹脂のエポキシ基に対し、 であることが硬化剤中のヒドロキシル基がほぼ当量になるように用い 50 量%である。

【0013】本発明における硬化剤は、二種類のフェノール樹脂を併用するものであるが、その使用法は単に硬化時に同時に配合する方法でも良いが、好ましくはあらかじめ任意の割合で均一に混練された物を用いる方がより好ましい。すなわち、一般式(I)で表されるナフトールアラルキル樹脂および、一般式(III)に示されるフェノールージシクロペンタジエン樹脂あるいは一般式(IV)に示されるフェノールアラルキル樹脂を混合することにより、溶融粘度が下がり、前記各性能において優れる他、作業性における優位さをも達成することができるものである。

【0014】また、その他の硬化剤として使用されるフェノールージシクロペンタジエン樹脂は、特公昭41-14099、特開昭47-35000、61-168624、62-4720、63-99224、米国特許3、336、398等により公知であり、これらの方法によれば、ジシクロペンタジエン1モルに対し、一般式(VI)(化16)

【化17】

(V I)

る。すなわちエポキシ基1当量に対し、硬化剤中のヒドロキシル基が0.5~1.5当量、好ましくは0.8~1.2当量の範囲になるように調整される。また、本発明において用いられる硬化剤の、ナフトールアラルキル樹脂とフェノールージシクロベンタジエン樹脂またはフェノールアラルキル樹脂との比は、任意の割合を選出とができるが、ナフトールアラルキル樹脂が95重量%とを越えるとその溶融粘度が上がり、また5重量%以下を越えるとその控能があまり発揮されなくなるため、硬化剤中に占めるナフトールアラルキル樹脂の割合は、5重量%~95重量%の範囲にあることが好ましいが、この比の選択は、使用目的における要求される性能を鑑みて判断すればよい。

【0017】さらに、本発明のエポキシ樹脂には無機充填剤を配合して用いることができる。使用される無機充填剤としてはシリカ、アルミナ、窒化珪素、炭化珪素、タルク、ケイ酸カルシウム、炭酸カルシウム、マイカ、クレー、チタンホワイト等の粉体、ガラス繊維、カーボン繊維、等の繊維体が例示される。これらの中で熱膨率と熱伝導率の点から、結晶性シリカおよび/または溶融性シリカが好ましい。更に樹脂組成物の成形時の流動性を考えると、その形状は球形、または球形と不定型の混合物が好ましい。無機充填剤の配合量は、エポキシ樹脂および硬化剤の総重量に対して100~900重量%であることが必要であり、好ましくは200~600重

10

11

【0018】また本発明においては、機械的強度、耐熱 性の点から各種の添加剤をも配合することが望ましい。 すなわち樹脂と無機充填剤との接着性向上の目的でカッ プリング剤を併用することが好ましく、かかるカップリ ング剤としてはシラン系、チタネート系、アルミネート 系、およびジルコアルミネート系等のカップリング剤が 使用できる。その中でもシラン系カップリング剤が好ま しく、特にエポキシ樹脂と反応する官能基を有するシラ ン系カップリング剤が最も好ましい。かかるシラン系カ ップリング剤の例としては、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、N-(2-アミノメチ ル) - 3 - アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N - (2-アミノエチル) - 3-アミノプロピルトリメト キシシラン、3-アミノプロビルトリエトキシシラン、 3-アニリノプロピルトリメトキシシラン、3-グリシ ドキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシ プロピルメチルジメトキシシラン、2-(3,4-エポ キシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-メル カプトプロピルトリメトキシシラン等を挙げることがで き、これらを単独、あるいは併用して使用することがで ➡ きる。これらのシラン系カップリング剤は、予め無機充 填剤の表面に吸着あるいは反応により固定化されている のが好ましい。

【0019】本発明において、樹脂組成物を硬化させる にあたっては、硬化促進剤を使用することが望ましい。 かかる硬化促進剤としては、2-メチルイミダゾール、 2-メチル-4-エチルイミダゾール、2-ヘプタデシ ルイミダゾール等のイミダゾール類、トリエタノールア ミン、トリエチレンジアミン、N-メチルモルホリン等 のアミン類、トリブチルホスフィン、トリフェニルホス フィン、トリトリルホスフィン等の有機ホスフィン類、 テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルポレート、 トリエチルアンモニウムテトラフェニルボレート等のテ トラフェニルポロン類、1,8-ジアザービシクロ (5, 4, 0) ウンデセン-7およびその誘導体があ る。上記硬化促進剤は、単独で用いても2種類以上を併 用してもよく、また、これら硬化促進剤の配合はエポキ シ樹脂および硬化剤の合計量100重量部に対して0. 01~10重量部の範囲で用いられる。

【0020】該樹脂組成物には、上記各成分の他、必要に応じて脂肪酸、脂肪酸塩、ワックスなどの離型剤、プロム化合物、アンチモン、りん等の難燃剤、カーボンプラック等の着色剤、各種シリコーンオイル等を配合し、混合、混練して成形材料とすることができる。

[0021]

【実施例】次に、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明はこれにより何ら制限されるものではない。 高速液体クロマトグラフィーによる樹脂の組成は、面積 %で示す。 【0022】合成例 1

提押器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ、およの冷却器を装着した反応装置に α, α'ージメトキシーカーキシレン 2 4 9 g (1.5 モル)とβーナフトール6 4 8 g (4.5 モル)、トリフロロメタンズルホン酸0.45 gを装入し、提押を行いながら150~160℃で4時間反応を行った。生成するメタノールは、順大トラップし、系外へ除去した。反応終了後、未反応大り、一ルを減圧蒸留により除去し、一般式(I)の構造を持つ465 gのβーナフトールアラルキル樹脂を得た。高速液体クロマトグラフィーによる樹脂の組成は、 n=0が51.0%、 n=1が25.7%、 $n \ge 3$ が10.6%であった。この樹脂のヒドロキシ当量は、232.5 g/e qであった。また、軟化点は98℃であり、ICI溶融粘度(150℃)は10.2 Poiseであった。

【0023】合成例 2

攪拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ、およ び冷却器を装着した反応装置に合成例1で製造したナフ トールアラルキル樹脂150g、エピクロルヒドリン2 98.4g(3.23モル)を装入し、攪拌を行いなが ら115℃に加熱し、完全に溶解させた。引き続き攪拌 を続けながら40%水酸化ナトリウム水溶液71.0g を2時間で滴下した。滴下中、反応温度は100~11 5℃に保ち、共沸されてくるエピクロルヒドリンは系内 に戻し、水は系外へ除去した。40%水酸化ナトリウム 水溶液の滴下が終了した後、水の留出がなくなるまで反 応を続けた。反応終了後、室温まで冷却し副生した無機 塩を濾過した。濾過液からエピクロルヒドリンを減圧蒸 留し、ナフトールアラルキル樹脂の粗エポキシ化物を2 32.1g得た。この粗エポキシ化物を700gのメチ ルイソプチルケトンに溶解し、5%水酸化ナトリウム水 溶液50gを加え、60℃において30分間攪拌した。 静置した後下層にくる水層を排出し、有機層を1%りん 酸2水素ナトリウム水溶液100gで中和した後100 gの水で3回洗浄してメチルイソプチルケトンを減圧蒸 留して除去した。このようにしてナフトールアラルキル 樹脂の精エポキシ樹脂228.5gを得た。このものの エポキシ当量は303.7g/eqであり、軟化点は6 40 9℃であった。

【0024】合成例 3

攪拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ、および冷却器を装着した反応装置にα,α'ージメトキシーpーキシレン249g(1.5モル)とαーナフトール432g(3.0モル)、トリフロロメタンスルホン酸0.15gを装入し、攪拌を行いながら150~160℃で4時間反応を行った。生成するメタノールは、順次トラップし、系外へ除去した。反応終了後、未反応ナフトールを滅圧蒸留により除去し、一般式(I)の構造を30持つ454gのαーナフトールアラルキル樹脂を得た。

10

高速液体クロマトグラフィーによる樹脂の組成は、n=0が32.8%、n=1が23.5%、n=2が15.2%、 $n \ge 3$ が28.5%であった。この樹脂のヒドロキシ当量は、234.1g/eqであった。また、軟化点は96℃であり、ICI溶融粘度(150℃)は1

【0.025】合成例 4

4. 7 Poiseであった。

攪拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ、およ び冷却器を装着した反応装置に合成例3で製造したナフ トールアラルキル樹脂150g、エピクロルヒドリン2 96.4g(3.20モル)を装入し、攪拌を行いなが ら115℃に加熱し、完全に溶解させた。引き続き攪拌 を続けながら40%水酸化ナトリウム水溶液70.5g を2時間で滴下した。滴下中、反応温度は100~11 5℃に保ち、共沸されてくるエピクロルヒドリンは系内 に戻し、水は系外へ除去した。40%水酸化ナトリウム 水溶液の滴下が終了した後、水の留出がなくなるまで反 応を続けた。反応終了後、室温まで冷却し副生した無機 塩を濾過した。濾過液からエピクロルヒドリンを減圧蒸 留し、ナフトールアラルキル樹脂の粗エポキシ化物を2 29. 7g得た。この粗エポキシ化物を700gのメチ 🔩 ルイソプチルケトンに溶解し、5%水酸化ナトリウム水 溶液50gを加え、60℃において30分間攪拌した。 静置した後、下層にくる水層を排出し、有機層を1%り ん酸2水素ナトリウム水溶液100gで中和した後、1 00gの水で3回洗浄してメチルイソプチルケトンを減 圧蒸留して除去した。このようにしてナフトールアラル キル樹脂の精エポキシ樹脂228.5gを得た。このも ののエポキシ当量は305.1g/eqであり、軟化点

は66.5℃であった。 【0026】合成例 5

授拌器、温度計、および冷却器を装着した反応装置にフェノール423g(4.5モル)とメタンスルホン酸 0.45gを挿入し、 $40\sim50$ ℃において攪拌を行いながら、ジシクロペンタジエン198g(1.5モル)を3.5時間で滴下した。同温度で1時間攪拌を続けた後、1時間で140℃まで昇温し、140~150℃で3時間反応を行った。反応終了後、未反応フェノールを減圧蒸留により除去し、一般式(1)の構造を持つ410gのフェノールージシクロペンタジエン樹脂を得た。高速液体クロマトグラフィーによる樹脂の組成は、n=0が49.7%、n=1が26.5%、n=2が10.8%、n ≥ 3が13.0%であった。この樹脂のヒドロキシ当量は、172.5g/eqであった。また、軟化点は121℃であり、ICI溶融粘度(150℃)は3.2Poiseであった。

【0027】合成例 6

攪拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ、および冷却器を装着した反応装置にα,α'ージメトキシー pーキシレン249g(1.5モル)とフェノール42 $5g(4.5 \pm N)$ 、メタンスルホン酸 0.34gを挿入し、攪拌を行いながら $140 \sim 150$ $\mathbb C$ で 4 時間反応を行った。生成するメタノールは、順次トラップし、系外へ除去した。反応終了後、未反応フェノールを滅圧蒸留により除去し、一般式(III)の構造を持つ 303 g のフェノールアラルキル樹脂を得た。による樹脂の組成は、n=0 が 50.8 %、n=1 が 24.3 %、n=2 が 11.6 %、 $n \ge 3$ が 13.3 %であった。この樹脂のヒドロキシ当量は、168.5 g / e q であった。また、軟化点は 52 $\mathbb C$ であり、ICI 溶融粘度(150 $\mathbb C$)は 3.8 Poise であった。

【0028】実施例 1

【0029】実施例 2

【0030】 実施例 3

【0031】 実施例 4

測定した。(表1)に結果を示す。

【0032】実施例 5~8

実施例1~4と同様の樹脂を用い、さらに無機充填剤、 その他各種添加剤を(表2)の様な割合で配合し、その 混合物を注型加工して得られる硬化物の物性を測定し た。(表2)に結果を示す。

【0033】比較例 1

エポキシ樹脂として、ピスフェノールA型エポキシ樹脂 (商品名;エピコート828、油化シェル化学製)、硬 #558, 昭和高分子製)を用い、(表1)の様な割合 で配合し、その混合物を注型加工して得られる硬化物の 物性を測定した。 (表1) に結果を示す。

【0034】比較例 2

比較例1における硬化剤を、4、4'ージアミノジフェ ニルスルホン (商品名:スミキュアS、住友化学製)に 代え、同様にして得られる硬化物の物性を測定した。

(表1)に結果を示す。

【0035】比較例 3

比較例1におけるエポキシ樹脂を、o-クレゾールノボ 20 ラック型エポキシ樹脂(商品名; EOCN-102S、

■ 日本化薬製)に代え、同様にして得られる硬化物の物性 を測定した。 (表1) に結果を示す。

【0036】比較例 4~6

比較例1~3と同様の樹脂を用い、さらに無機充填剤、 その他各種添加剤を(表2)の様な割合で配合し、その 混合物を注型加工して得られる硬化物の物性を測定し た。(表2)に結果を示す。

【0037】比較例 7

実施例5において、無機充填剤の配合量をエポキシ樹脂 30 と硬化剤の総重量の80%となる様に配合し、得られる 硬化物の物性を測定した。但し、全体の重量は等しくな る様に配合量を調整した。(表2)に結果を示す。

【0038】物性測定用の試験片は、樹脂混合物を用い て、フラットパッケージ型半導体装置用リードフレーム の素子搭載部に、試験用素子(10mm×10mm角) を搭載した後、トランスファー成形 (180℃、30k g/cm2, 3min) により得た。これを試験用半導 体装置として用いた。

【0039】 (表1) に示される様に、本発明において 40 得られるナフトールアラルキル樹脂のエポキシ化物とナ フトールアラルキル樹脂および、フェノールージシクロ ペンタジエン樹脂またはフェノールアラルキル樹脂から 得られる硬化物は、その耐熱性、耐湿性、機械的性質が 高い水準にあり、性能のパランスがとれていると言え る。これに対し、比較例1~3で示される従来のエポキ シ樹脂と硬化剤の組合せから得られる硬化物は、各性能

とも劣っており、特に比較例1、2の様に、耐熱性と耐 湿性は他方を犠牲にした上に得られる場合がほとんどで

【0040】また、(表2)において無機充填剤および その他の添加剤をも用いて得られる硬化物の物性を示し た。実施例5~8および比較例4~6はそれぞれ(表 1) における実施例1~4、比較例1~3に対応するも のであるが、この(表2)より無機充填剤を添加するこ とにより耐水性、機械的性質が大幅に向上することがわ 化剤としてフェノールノボラック樹脂(商品名; BRG 10 かる。比較例7において、無機充填剤の使用量が本発明 の範囲である樹脂の総重量の100%以下であると、そ. の効果は無いに等しいものであることがわかる。 これ らのことから、本発明により耐熱性、耐湿性、機械的強 度等に優れ、且つ性能のパランスのとれたエポキシ樹脂 組成物を得ることができる。

> 【0041】(表1、2)で用いた記号、物質及び測定 法を下記に示す。

- ・エピコート828; ピスフェノールA型エポキシ樹脂 (油化シェル化学製)
- · EOCN-102S; o-クレゾールノボラック型エ ポキシ樹脂(日本化薬製)
 - ・BRG#558;フェノールノボラック樹脂(昭和高 分子製)
 - ・スミキュアS; 4, 4' -ジアミノジフェニルスルホ ン(住友化学製)
 - ・C112;2-ウンデシルイミダゾール(四国ファイ ンケミカル製)
 - 無機充填剤;球形溶融シリカ(ハリミックS-CO. (株)マイクロン製)
- 50重量部と不定型溶融シリカ(ヒューズレックスRD -8 (株) 龍森製) 50重量部との混合物
 - ・シランカップリング剤; (SZ-6083, 東レダウ コーニングシリコーン(株)製)
 - ・ガラス転移温度;TMA法 (島津 TMA-システム DT-30で測定)
 - ・曲げ強度、弾性率: JIS K-6911
 - ・煮沸吸水率;100℃の沸騰水中で2時間煮沸後の重 量増加を測定。
- ・V. P. Sテスト;試験用の半導体装置を65℃、9 5%の恒温恒湿槽に168時間放置した後、直ちに21 5℃のフロナート液(住友スリーエム(株)製、FC-70)に投入し、パッケージ樹脂にクラックが発生した 半導体装置の数を数えた。

試験値を分数で示し、分子はクラックの発生した半導体 装置の数、分母は試験に供した半導体装置の数である。

[0042]

【表1】

		実施例1	実施例2	実施例3	実施例 4	比較例 1	比較例 2	比較例3	
	合成例 2	100		100					·
	合成例 4		1 0 0		100				1
呂	エピコート828					1 0 0	ţ		7
	EOCN-102S							1 0 00	т
	合成例 1	62.6	48.9					APPE I	
	合成例 3			12.2	33.0				· · · · · ·
	合成例 5	11.0		48.7					γ
	合成例 6		2 1. 0		33.0				
√ □	BRG#558					54.7		48.6	
	DDS						32.6		·
	C112		- ‡	ţ	ţ	ţ	ţ	ţ	1
Pripat	硬化条件(℃/Hr)			145/3	3 + 1 8	8 0.76			
H	ガラス転移温度(℃)	188	184	186	182	150	177	1 7 8	
#	強度 (kgf/mm2)	13.5	13.7	12.8	1 3. 8	12.8	11.4	12.2	18
Ţ.	弹性率 (kgf/mm2)	358	098	350	364	3 4 8	325	3 3 8	
横	煮沸吸水率(D-2/100)(%)	0.21	0.22	0.20	0.23	0.58	0.67	0.64	
									<u>,</u>

		東施朗5	東馬鹿 6	米特成7	林精空8	比较例 4	比較例 5	比较图 6	比较图7	
	合成例 2	100		100					298.8	
	合成例 4		100		0 0 1	,				Γ
	エピコート828					0 0 1	ļ			19
H	EOCN-102S							100		_
	合成例 1	62.6	48.9						187.	
	合成例 3			12.2	33.0					_
•	合成例 5	11.0		48.7					3 2 . 9	т —
	合成列 8		21.0		33.0				×	_
	BRG#558					54.7		48.6		,
	DDS	·					32.6			1
	無機充塡対	700	ŧ	ŧ	+	ł	-	1	382.2	
₽	シランカップロンダ色	0 9	+	-	+	ţ	+	ţ	32.8	,
	カルナパワックス	4.5	+	4	-	.		+	ı	, —
	カーポンプラック	8	→	-	→	ţ	Ţ	ţ	ı	_
	酸化アンチモン	1.0	-	•	+	ŧ	ţ	ţ	ı	1
	硬化条件(で/Hr)			1 -	15/3 +	+ 180	9/			
₹	ラス転移躍度(℃)	881	184	186	182	150	177	178	1 8 8	·
田	強度 (kgf/mn2)	13, 5	13.7	12.8	13.8	12.8	11. 4	12.2	13.5	20
Ţ	弹性率 (kgf/mm2)	1550	1565	1500	1610	1490	1340	1380	355	
#	煮沸吸水率(D-2/100)(%)	0.11	0.11	0.10	0. 12	0.33	0.38	0.25	0.21	
٧.١	V.P.S テスト (クラック発生数)	0 2 / 0	1/20	0 / 2 0	2/20	17/20	20/20	17/20	20/20	
										,

[0044]

【発明の効果】本発明により提供されるエポキシ樹脂組成物は、耐熱性と耐湿性に優れ、更に機械的性質、接着性、耐クラック性、作業性に優れているため、各種マトリックス樹脂として極めて有用性が高いものである。こ 40

のことは、特に、従来性能的に一長一短があるために使用が制限されていた半導体封止剤分野において理想的な材料を提供するものであり、その貢献するところは大きい。